

(第 1 号議案)

2024 年 5 月 13 日

第 15 期 事業計画(案)

至 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

一般財団法人 大阪大学産業科学研究所

1. 活動方針

科学技術による産業の発展・それによる生活の向上に貢献するために、产学間の連携をより一層緊密にし、事業化等も視野に入れた新たな連携方策の展開を図っていく必要があります。本協会は、真の产学連携の実をあげるべく、大阪大学産業科学研究所関連の研究成果のシーズを広く世の中に情報発信し、産業界との橋渡しが出来るような事業を積極的に展開していきます。先端科学技術知識の産業界への普及事業、新産業の創造に向けた新産業創造支援事業、に加えて、産業界のニーズに基づく新技術の実用化を図るべく、産業界との新たな関係づくりに取組み、更なる産学連携事業の発展を目指します。

第 15 期 (2024 年度) は、2020 年 1 月から続く新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン化・ハイブリッド化の常態化により不足していた対面での情報交換、交流会の場を再構築する。

2. 先端知識普及事業

(1) 産研テクノサロン (シーズとニーズのマッチング・交流の会)

位置付け：産研シーズと民間企業のニーズのマッチングの場

対象：会員企業、研究所教員および産業界一般

開催回数：4 回／年 (第 111 回～第 114 回)

産研戦略室・産研テクノサロン運営委員会において企画を行う。

(2) 産研ざっくばらんトーク (2016 年 4 月より開始、2019 年の第 25 回をもって休止中)

位置付け：産研の研究内容の紹介と対話を通じての深い理解と応用検討の場 (主として教授クラスを対象として企画を立案・展開)

対象：主として会員企業

開催回数：不定期開催／年 (対面が可能な場合)

産研戦略室と共同で再開に向けての企画立案を行う予定である。

(3) 学術講演会

位置付け：産研の研究成果・保有技術等の情報提供と議論の場

対象：研究者および広く産業界一般

開催回数：1 回／年

(4) 協会ホームページ、メールによる情報提供並びに研究所活動の紹介

- ・ホームページ URL : <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/RAIS/>
- ・情報提供については、
①会員企業名公開：新規会員入会・社名変更等に伴い更新(入会時に「社名公開の可否について」問い合わせ済)
<https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/RAIS/about/membership.html>
②産学連携情報の公開：
https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/RAIS/academic_industrial_alliance/index.htmlを主軸としてホームページを通じた情報提供を行う。

(5) 産研 CTO サロン

産研の将来有望な研究シーズの社会実装を推進するため、10～20 年先を見据えた産学連携の仕組み、運営のありかたを検討する。企業 CTO、技術幹部、理事長、産研所長が参加する CTO サロン、及び実務 WG を複数回/年開催する。6 社の産学連携の事例を共有して、産研との産学連携のありかたを追求するため、各社持ち回り開催を継続する。

(6) テクノサロン交流会については、2024 度は毎回開催予定。

産研テクノサロンは本来のリアル開催を主体的とし、講演会後の意見交換会交流会を含め対面での情報交換の場を充実させる。

3. 新産業創造促進事業

(1) 新産業創造研究会

「核酸を標的とした低分子創薬研究会 (DNA 研究会)」(中谷教授、2016～2019 年度)、「バイオナノフォトニクス新産業創造研究会 (BNP 研究会)」(永井教授、2016～2019 年度)、および「香り・におい・ガスセンサー研究会 (AOSG 研究会)」(黒田教授、2021～22 年度) 以降、あらたな新産業創造研究会事業が発足していない。
今年度は、産研戦略室と共にあらたな新産業創造研究会事業の立上げを検討する。

(2) 新産業創造支援事業

①プリントエレクトロニクス (PE) 研究会

国内に新たな市場を見据えたプリントエレクトロニクスに関する統合的な情報交換、情報発信、共同開発提案の場

担当教員：第 1 研究部門 先進電子デバイス研究分野 関谷毅教授

開催：4 回／年を基本とする。さらに ACS (米国化学学会) など海外組織と連携した公開シンポジウムを適宜開催する。

②フレキシブル 3D 実装コンソーシアム

フレキシブル 3D 実装協働研究所で活動中の「フレキシブル 3D 実装コンソーシアム」活動に「WBG 実装 WG」と「先端半導体パッケージング WG」の二つのワーキンググループを設置する。コンソーシアム会員はどちらかもしくは両方の WG に参画する。

WG1：「WBG 実装 WG」 新材料、新プロセス、新評価基準と技術、更に新たな実装設計を組み合わせ、セラミック／金属界面設計に基づくパワー半導体実装技術、評価方法の確立を目指す。

WG2：「先端半導体パッケージング WG」 先端パワー半導体や AI / IoT を支える高密度 3D 半導体などの研究を対象とし、これらの実装における異相界面現象に関わる新技術開発や市場における様々な技術課題の理解と解決を目指す。

担当教員：フレキシブル 3D 実装協働研究所 菅沼克昭特任教授

開催：各 WG とも 4 回／年の研究会開催を基本とする。

③新産業創造支援事業における産研協会の主要な支援業務（会計管理など）について、業務委託契約書を取り交わして支援を実施する。

（各 WG で別途参加会費を募って開催する国際シンポジウムや海外研究所訪問など特別プロジェクトの業務支援については、会費総額の 10%相当を追加徴収することを契約に追記）

4. 産業科学研究所に対する支援活動

F3D 実装協働研究所 菅沼所長が中心となって進める「大阪大学半導体人材育成」活動への上記 F3D 実装コンソーシアムとともに産研協会として支援を行う。

5. 会員の獲得他

（1）会員（賛助員）数増加に向けての取り組み

産研戦略室との連携：技術相談等で関係する非会員企業への勧誘活動を推進する。（大学との共同研究とするには時間を要する企業案件の課題解決を協会のネットワークを用いて行う。）

（2）研究所に対する支援活動（継続）

- ① 会員企業による企業リサーチパークの利用の促進
- ② 企業リサーチパーク交流会の支援
- ③ 会員企業と研究所との交流支援（テクノサロン後の交流会、会員交流会など）

（3）PR 活動など

産研戦略室、産研広報室および会員との連携活動により、産研及び協会の PR 活動を推進。

一般財団法人 大阪大学産業科学研究所の組織と事業

